

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成18年1月19日(2006.1.19)

【公開番号】特開2000-275059(P2000-275059A)

【公開日】平成12年10月6日(2000.10.6)

【出願番号】特願平11-83641

【国際特許分類】

G 01 D 5/245 (2006.01)

G 01 R 33/09 (2006.01)

【F I】

G 01 D 5/245 R

G 01 R 33/06 R

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月25日(2005.11.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

また、図8a)もしくは図8b)に示す方式がある。図8a)は、四弗化工チレン系樹脂やポリアミド系樹脂シート7を磁気媒体1の外周に貼り付ける構成である。図8b)は磁気センサ素子3にシート7を貼付け、前記シートを介して磁気媒体1と磁気センサ2を接触、摺動する方式である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

前記FPCの樹脂部の厚さを磁気センサと磁気記録媒体との間に等しくし、磁気媒体とFPC樹脂部を介して磁気センサを押しつけるだけでギャップgが容易に得られ、工数のかかるギャップ調整が容易になるばかりではなく、磁気媒体や磁気センサ表面の傷の発生も防ぐことができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0028】

FPCは、薄型と呼ばれているものでポリイミド系樹脂シート25μm、接合接着層35μm、銅回路層35μm、接合接着層35μm、ポリイミド系樹脂シート25μmの5層で合計155μm厚のものを使用した。磁気センサ素子3を覆うようにFPCの樹脂部15が配置されるが、銅回路層35μm、両側の接合接着層、片側のポリイミド樹脂シートが無いためFPCの樹脂部15は25μmの厚みである。FPCの樹脂部15は磁気センサ素子3とは樹脂等で接着されることなく、銅回路層厚35μmと接合部8の半田厚に約10μmの合計約45μmの空隙を磁気センサ素子3との間に持った状態で保持されている。

以 上